

Distributed by:

JAMECO[®]
ELECTRONICS

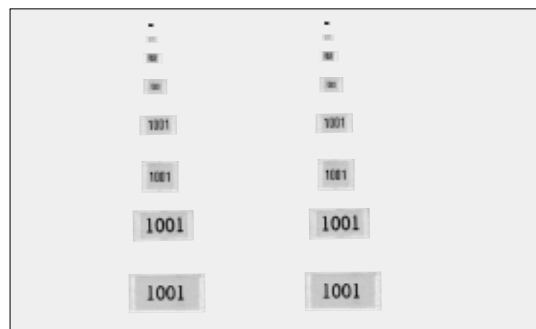
www.Jameco.com ♦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached
material are the property of its owner.

Jameco Part Number 1882973

THICK FILM (PRECISION)

RK73H 角形チップ抵抗器(精密級) Flat Chip Resistors (Precision Grade)



外装色：黒(1H),
青(1E, 1J, 2A, 2B, 2E, 2H, 3A)
Coating color : Black (1H),
Blue (1E, 1J, 2A, 2B, 2E, 2H, 3A)

■特長 Features

- 小型・軽量です。
- 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
- 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
- テーピング、バルクケース方式等の各種自動実装機に対応します。
- リフロー、フローはんだ付けに対応します。
- Small size and light weight.
- 端子鉛フリー品は、RoHS対応です。電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの適用除外です。
- Excellent heat resistance and weather resistance are ensured by the use of metal glaze thick film.
- High stability and high reliability with the triple-layer structure of electrode.
- Applicable to various kinds of automatic mounters for taping, bulk case, etc.
- Suitable for both flow and reflow solderings.
- Products with lead free termination meet RoHS requirements. RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.

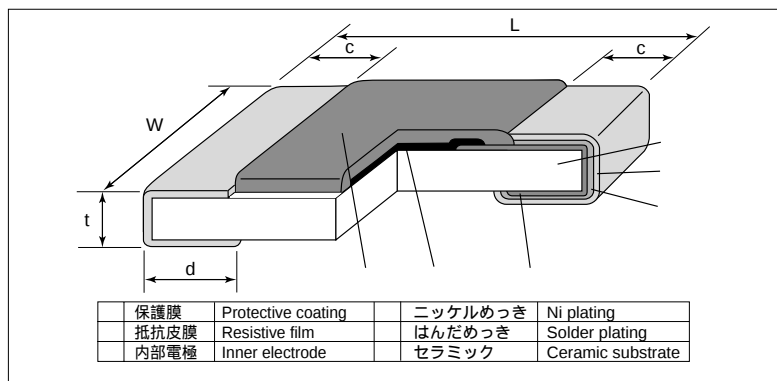
■品名構成 Type Designation

例 Example

Old Type	RK73H	2B		TD	10kΩ	F
New Type	RK73H	2B	T	TD	1002	F
品種 Product Code	定格電力 Power Rating	端子表面材質 Terminal Surface Material	二次加工 Taping	公称抵抗値 Nominal Resistance	抵抗値許容差 Resistance Tolerance	
	1H : 0.05W 1E : 0.063W 1J : 0.1W 2A : 0.125W 2B : 0.25W 2E : 0.33W 2H : 0.75W 3A : 1W	T : Sn G : Au ± L : Sn/Pb	TC:TCM:2mm pitch press paper TP: 2mm pitch punch paper TD: 4mm pitch punch paper TE: 4mm pitch plastic embossed BC: Bulk case BK: Bulk	4 digits	D : ± 0.5% F : ± 1%	

※1 金めっき電極品は、1E、1J、2A (10Ω～1MΩ) で対応しております。
仕様が若干異なりますので、弊社までご相談下さい。
※1 Products with gold plated electrodes are also available with 1E, 1J and 2A types
(10Ω～1MΩ), so please consult with us.
端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.

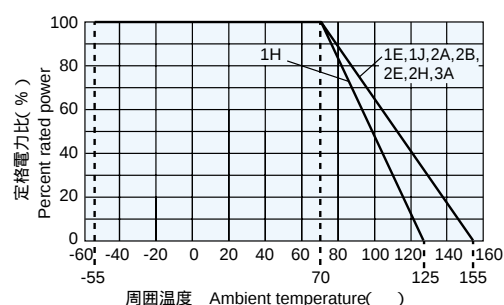
■構造図 Construction



■外形寸法 Dimensions

形名 Type (Inch Size Code)	寸法 Dimensions (mm)					Weight (g) (1000pcs)
	L	W	c	d	t	
1H (0201)	0.6 ± 0.03	0.3 ± 0.03	0.1 ± 0.05	0.15 ± 0.05	0.23 ± 0.03	0.14
1E (0402)	1.0 ^{+0.1} _{-0.05}	0.5 ± 0.05	0.2 ± 0.1	0.25 ^{+0.05} _{-0.1}	0.35 ± 0.05	0.68
1J (0603)	1.6 ± 0.2	0.8 ± 0.1	0.3 ± 0.1	0.3 ± 0.1	0.45 ± 0.1	2.14
2A (0805)	2.0 ± 0.2	1.25 ± 0.1	0.4 ± 0.2	0.3 ^{+0.2} _{-0.1}	0.5 ± 0.1	4.54
2B (1206)	3.2 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.5 ± 0.3	0.4 ^{+0.2} _{-0.1}	0.6 ± 0.1	9.14
2E (1210)		2.6 ± 0.2				15.5
2H (2010)	5.0 ± 0.2	2.5 ± 0.2		0.65 ± 0.15		24.3
3A (2512)	6.3 ± 0.2	3.1 ± 0.2				37.1

■負荷軽減曲線 Derating Curve



周囲温度70℃以上で使用する場合は、上図に示す負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減して御使用下さい。
For resistors operated at an ambient temperature of 70℃ or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

■参考規格 Reference Standards

IEC 60115-8
JIS C 5201-8
EIAJ RC-2134A

■定格 Ratings

形名 Type	抵抗温度 係数 T.C.R. (×10 ⁻⁶ /K)	定格電力 Power Rating	抵抗値範囲 Resistance Range (Ω)		最高 使用電圧 Max. Working Voltage	最高 過負荷 電圧 Max. Overload Voltage	二次加工と包装数 Packaging & Q'ty/Reel or Case						
							テーピング Taping					バルクケース Bulk Case	
			D:±0.5% E24・E96	F:±1% E24・E96			TC	TCM	TP	TD	TE		BC
1H	±200	0.05W	10～1M ²	10～1M ²	25V	50V	10,000	15,000	—	—	—	—	
1E	±400	0.063W	—	1.0～9.76	50V	100V	—	—	10,000	—	—	—	
	±200		—	1.02M～10M									
1J	±100	0.1W	10～976k	10～1M			—	—	10,000	5,000	—	25,000	
	±400		—	1.0～9.76									
	±200		—	1.02M～10M									
2A	±400	0.125W	—	1.0～9.76	150V	200V	—	—	10,000	5,000	4,000	10,000	
	±100		10～1M	1.02M～10M									10～1M
2B	±400	0.25W	—	1.0～9.76	200V	400V	—	—	—	5,000	4,000	5,000	
	±200		—	5.62M～10M									1.02M～5.6M
	±100		10～1M	10～1M									
2E	±400	0.5W	—	1.0～9.76			—	—	—	5,000	4,000	—	
	±200	0.33W	—	5.62M～10M									1.02M～5.6M
	±100	0.5W	10～1k	10～1k									
2H	±400	0.75W	—	1.0～9.76			—	—	—	—	4,000	—	
	±200		—	5.62M～10M									1.02M～5.6M
	±100		10～1M	10～1M									
3A	±400	1.0W	—	1.0～9.76			—	—	—	—	4,000	—	
	±200		—	5.62M～10M									1.02M～5.6M
	±100		10～1M	10～1M									

定格周囲温度 Rated Ambient Temperature : $+70^{\circ}\text{C}$

使用温度範囲 Operating Temperature Range : $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ (1H)、 $-55^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$ (1E・1J・2A・2B・2E・2H・3A)

定格電圧は $\sqrt{\text{定格電力} \times \text{公称抵抗値}}$ による算出値、又は表中の最高使用電圧のいずれか小さい値が定格電圧となります。

Rated voltage = $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance value}}$ or Max. working voltage, whichever is lower.

※2 RK73H1H (D : $\pm 0.5\%$ 、F : $\pm 1\%$) の公称抵抗値はE24となります。

※2 The nominal resistance value for RK73H1H (D : $\pm 0.5\%$ 、F : $\pm 1\%$) is E24.

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements $\Delta R \pm (\% + 0.05 \Omega)$		試験方法 Test Methods
	保証値 Limit	代表値 Typical	
抵抗値 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	—	25
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R.	—	$+25$ / -55 and $+25$ / $+125$
過負荷(短時間) Overload(Short time)	2	0.5	定格電圧 $\times$ 2.5 倍を 5 秒印加 Rated voltage $\times$ 2.5 for 5s
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	1 : 1H 1E ~ 3A(10 Ω R 1M Ω) 3 : 1E ~ 3A(R < 10 Ω , R > 1M Ω)	0.75 : 1H 1 : 1E ~ 3A(R < 10 Ω , R > 1M Ω) 0.5 : another	260 $\pm$ 5 , 10s $\pm$ 1s
温度急変 Rapid change of temperature	0.5	0.3	- 55 (30min.) γ + 125 (30min.) γ 100 cycles
耐湿負荷 Moisture resistance	2 : 1J, 2A, 2B 3 : another	0.75 : 1J, 2A, 2B 1 : another	40 $\pm$ 2 , 90% ~ 95%RH, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
70 での耐久性 Endurance at 70	2 : 1J, 2A, 2B 3 : another	0.75 : 1J, 2A, 2B 1 : another	70 $\pm$ 2 , 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
低温放置 Low temperature exposure	1	0.3	- 55 , 1h
高温放置 High temperature exposure	1	0.3	+ 125 , 1000h : 1H + 155 , 1000h : 1E, 1J, 2A, 2B, 2E, 2H, 3A

■使用上の注意 Precautions for Use

- チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装する基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ（はんだフィレット部）にクラックが発生する場合があります。特に2H・3Aの大型タイプの場合、熱膨張が大きく、また、自己発熱も大きいことより、周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。一般的なヒートサイクル試験をガラエポ基板(FR-4)を用い、使用温度範囲の上限・下限で行った場合、1H~2Eのタイプでは、クラックは発生しにくいですが、2H・3Aタイプは、クラックが発生しやすい傾向にあります。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさと、はんだ量、実装基板の放熱性に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフの様な使用条件が想定される場合は、十分注意して設計して下さい。
- The substrate of chip resistors are alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated, especially when large types of 2H/3A which have large thermal expansion and also self heating. By general temperature cycle test using glass-epoxy(FR-4) boards under the maximum/minimum temperatures of operating temperature range, the crack does not occur easily in the types of 1H~2E, but the crack tends to occur in the types of 2H/3A. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.